

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

## 无锡帝科电子材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	浙商证券、德邦基金、中信建投证券、财通资管、中金公司、南土资产、北京锦桐基金、国联民生证券、东北证券、东吴证券、华宝基金、和谐汇一、浙商基金等16人。
时间	2025年3月4日-3月5日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：彭民先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 公司对2025年出货量的预期？</b></p> <p>答：近期光伏行业相关政策较多，公司需要进一步评估政策影响、以及下游客户的开工率情况，暂时无法准确预计2025年全年出货量目标。公司今年主要目标是重点服务优质龙头客户，提升公司的市占率。</p> <p><b>2. 公司在高铜浆料上的研发进展？</b></p> <p>答：在高铜浆料上，公司已经与龙头客户进行了长期合作开发，已经针对TOPCon等高温电池推出了高铜浆料设计与应用方案，预估在今年下半年有望推动大规模量产，同时积极推动相关解决方案在TBC电池领域的应用。</p> <p><b>3. 公司不同类型银浆的加工费情况？</b></p> <p>答：相较于2024年三季度，公司的TOPCon银浆加工费相对稳定，HJT和TBC电池的浆料加工费要高于TOPCon银浆。未</p>

来随着TBC/HJT等新电池技术产能的进一步增长，和高铜浆料及其他低银金属化技术创新与产业化发展，对于改善未来公司的盈利能力具有重要积极作用。

#### **4. 公司半导体浆料目前的进展以及后续的放量节奏？**

答：2024年，公司半导体封装浆料营业收入首次突破1000万元。公司将持续加强市场开发力度，持续优化客户结构，以导电浆料共性技术平台为依托，聚焦导电、导热、粘接互联等核心技术能力，通过配方设计优化与生产制程优化持续迭代完善（ $10\text{ W/m} \cdot \text{K}$ 常规导热系数、 $10\text{-}30\text{ W/m} \cdot \text{K}$ 高导热系数的LED/IC芯片封装银浆产品，与行业领先客户协同创新，持续推进功率半导体芯片封装粘接用超高导热系数（ $\geq 200\text{ W/m} \cdot \text{K}$ ）的有压烧结银、无压烧结银产品的优化迭代与车规级应用，以及功率半导体封装AMB陶瓷基板用高可靠性钎焊浆料产品的规模化量产，并进一步推出了对应的无银铜浆产品方案；在印刷电子浆料领域，与业界龙头企业合作在新能源汽车PDLC调光膜领域取得突破性进展；在电子元器件浆料领域，多款银浆与铜浆产品实现了行业领先的性能和应用成果。通过持续的技术研发与投入，以及加大市场拓展力度，公司半导体电子业务有望实现进一步的快速增长，为公司业绩带来积极贡献。

#### **5. 公司今年对于下游客户的账期是否有变化？**

答：公司一直以来始终坚持“高效、可靠、稳定”的产品策略，致力于为客户提供高性能的优质产品满足客户需求并参与市场竞争，公司对下游客户的账期相对稳定，公司也会根据客户资信状况做动态评估，比如对资信变差的客户收缩账期。

#### **6. 高铜浆料量产后的定价模式？**

答：随着技术的进步和成本的降低，未来高铜浆料的定价模式有望从加工费模式转变为产品直接计价模式，这将对公司未来发展带来积极影响。

#### **7. 公司目前高铜浆料的原材料供应商有哪些？**

	<p>答：高铜浆料需要使用不同形状和不同尺寸的粉体进行复配，公司使用的粉体供应商结构目前较为多元。购入相关粉体后，公司会进行独特的表面处理和配方增强，这也是相关浆料产品技术壁垒提升的一部分体现。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年3月5日